

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于筹划公司在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深化合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）国际化战略布局，加快海外业务发展，进一步提高公司综合竞争力及国际品牌形象，同时充分借助国际资本市场的资源与机制优势，优化资本结构，拓宽多元融资渠道，公司正在筹划发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次H股上市”）。公司正与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定。本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等相关规定，本次H股上市工作尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联合交易所有限公司等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。本次H股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有不确定性。

公司将依据相关法律法规的规定，根据本次H股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025年8月2日